

第 26 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時： 2019 年 7 月 10 日(水) 10:30～16:20

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

時 間	題 目	講 演 者
10:30～ 12:00	司会 森 貴裕 ((株) ADEKA)	
	『焼付乾燥工程における接着剤硬化とボディへの影響の解析』 (45 分)	小山 敦久、○小田切 亮(伊藤忠テクノソリューションズ(株))
	『銅-はんだ-樹脂複合材を用いた液相拡散接合部の特性と接合信頼性』 (45 分)	○巽 裕章 ^{1,2} 、Adrian Lis ² 、山口 博 ¹ 、加柴 良裕 ² 、廣瀬 明夫 ² (1.三菱電機(株)、2.大阪大学)
12:00～ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00～ 13:10	委 員 会 議 事	
13:10～ 14:40	司会 加柴 良裕(大阪大学)	
	『スルーホールリフローに適した Sn-Ag-Cu-Sb-In系高耐久はんだ合金の接合信頼性』 (45 分)	○和田 剛優、森 公章、白井 武史((株)弘輝)
	『超微細接合用ソルダペーストの開発とその応用事例』 (45 分)	○水野 裕次郎((株)ニホンゲンマ)
14:40～ 14:50	休 憩	
14:50～ 16:20	司会 荻谷 義治(芝浦工業大学)	
	『MEMS マイクロ流路と液体有機半導体とを用いた有機発光デバイスの開発』 (45 分)	○笠原 崇史(法政大学)、大島 寿郎(日産化学(株))、水野 潤(早稲田大学)
	『導体層を仲立ちとしたガラス同士の陽極接合』 (45 分)	○高橋 誠(大阪大学)

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。